

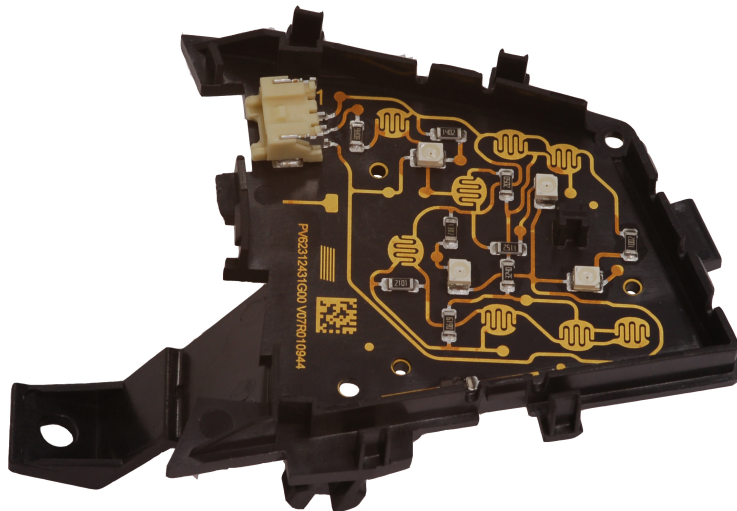
ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE  
DE LAUSANNE

MÉTHODES DE PRODUCTION

---

## Molded Interconnect Devices

---



*Étudiants :*  
Antoine ALBERTELLI  
Quentin HERZIG

*Enseignants :*  
Pr. Jacques JACOT  
Pr. Peter RYSER  
Dr. Jean-Daniel LÜTHI

13 décembre 2013



## Table des matières

1	Introduction . . . . .	2
2	Applications . . . . .	2
2.1	Automobile . . . . .	2
2.2	Médical . . . . .	3
2.3	Consumer Electronic . . . . .	3
3	Procédés de fabrication des MID . . . . .	4
3.1	Laser Direct Structuring . . . . .	4
	3.1.1 Principe de base du procédé . . . . .	4
	3.1.2 Métallisation . . . . .	5
3.2	Two-shot molding . . . . .	6
4	Conception de MID . . . . .	6
4.1	Matériaux utilisables . . . . .	6
4.2	Limites du procédé LDS . . . . .	7
4.3	Prototypage . . . . .	8
4.4	Comparatif entre PCB et MID . . . . .	9
5	Étude de coûts . . . . .	9
5.1	Injection . . . . .	10
5.2	Activation Laser . . . . .	12
5.3	Métallisation . . . . .	12
5.4	Récapitulatif . . . . .	14
5.5	Comparaison avec un PCB . . . . .	14
6	Remerciements . . . . .	16

## 1 Introduction

Un *Molded Interconnect Device* (MID) est un circuit électronique dont le support est un substrat thermoplastique moulé par injection, par opposition aux *Printed Circuit Boards* (PCBs) conventionnels dont le substrat est un composite plat.

Les MIDs permettent de regrouper dans une seule pièce des fonctions mécaniques et électroniques. En effet, contrairement aux PCBs, les MIDs peuvent être conçus en trois dimensions, ce qui réduit considérablement le nombre de composants et de connecteurs, diminuant ainsi le temps d'assemblage, et donc le coût du système.

Les MIDs ne sont toutefois pas une solution de remplacement des PCBs, car ils ne permettent pas une grande densité de pistes, tandis que les PCBs à plus de deux couches sont désormais peu coûteux et permettent des circuits à forte densité.

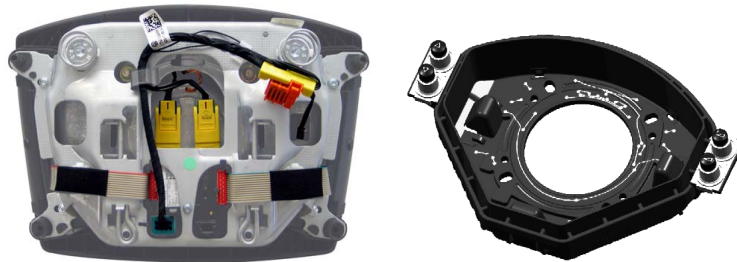
## 2 Applications

Les MIDs se rencontrent dans des domaines très variés, mais qui ont tous en commun de demander une forte intégration entre l'électronique et la mécanique.

### 2.1 Automobile

L'électronique embarquée dans les voitures devient de plus en plus complexe afin d'augmenter le confort et la sécurité des passagers. À l'inverse, le coût d'assemblage, le poids et par conséquent le nombre de pièces doivent être réduits afin de continuer à proposer des modèles abordables. Les MIDs sont des solutions adaptées pour remplacer les fils et la connectique, tout en intégrant des fonctions mécaniques, comme des boutons ou de la structure.

À la fig. 1, on peut remarquer le gain en simplicité obtenu dans le cas d'un volant multi-fonction. Ces volants, de plus en plus courants dans les voitures actuelles, permettent au conducteur de changer de chaîne de radio, de rapport de boîte à vitesse, etc. L'utilisation d'un MID a permis ici de simplifier le câblage : Les fils ont été supprimés et les boutons remplacés par des contacts recouvert d'un tapis conducteur en silicone.



(a) Volant multi-fonction conventionnel. (b) Volant multi-fonction MID (vue CAO)

Fig. 1: Exemple d'utilisation des MIDs dans l'automobile.

## 2.2 Médical

Une autre application intéressante des MIDs se situe dans le milieu médical, et plus particulièrement des implants auditifs. Ce secteur cherche en effet à miniaturiser de plus en plus ses produits, afin de les rendre plus discrets, ce qui demande une intégration entre électronique et mécanique très poussée. La fig. 2 montre l'utilisation faite par Siemens d'un MID comme châssis et connecteur d'un implant. Il n'existe, à notre connaissance, pas d'exemple d'utilisation de MID dans des prothèses vitales, comme des stimulateurs cardiaques.



Fig. 2: Chassis d'implant auditif, réalisé en MID.

## 2.3 Consumer Electronic

Dans le domaine de l'électronique grand public, la miniaturisation, la diversification et la réduction des coûts posent des difficultés importantes. Par exemple, créer une antenne miniaturisée en MID offre deux avantages majeurs par rapport aux antennes classiques et aux PCBs *trace antenna* :

- L'encombrement est réduit, soit en enroulant l'antenne sur elle même, soit en l'intégrant directement au châssis de l'appareil,
- La directivité de l'antenne est parfaitement maîtrisable, permettant ainsi une réception optimale quelle que soit l'orientation.

La fig. 3 montre l'utilisation des MIDs pour fabriquer une antenne miniature (4mm de côté) soudable sur un PCB et pour fabriquer une antenne intégrée au châssis d'un smartphone. Ces images proviennent de la société Molex, qui utilise les MIDs pour la production à très grande échelle et le prototypage de ses antennes.



(a) Antenne soudable sur PCB. (b) Antenne intégrée au boîtier.

Fig. 3: Utilisation des MIDs dans les antennes.

### 3 Procédés de fabrication des MID

Il existe actuellement 2 méthodes de production de MID sur le marché : le *Laser Direct Structuring* (LDS) et le *Two-shot molding*. Depuis son introduction sur le marché, le premier a pratiquement éclipsé le second, car celui ci est plus compliqué à mettre en œuvre et plus cher. Il était surtout utilisé pour produire des grandes quantités à bas coût, mais avec la baisse des prix, le LDS est désormais préféré pour la production de masse. Par exemple, Molex, le plus gros constructeur d'antennes SMD au monde utilise uniquement le procédé LDS.

#### 3.1 Laser Direct Structuring

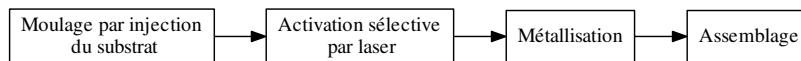


Fig. 4: Vue d'ensemble du processus *Laser Direct Structuring*

Le LDS est un procédé relativement récent, introduit sur le marché en 2006. C'est une technologie brevetée de LPKF Lasers & Electronics AG en Allemagne, ce qui rend l'utilisation d'une de leur machine obligatoire. Leur site web <sup>1</sup> est donc une excellente source d'informations pour la conception de pièces utilisant le LDS.

##### 3.1.1 Principe de base du procédé

Le principe général du procédé est visible à la fig. 4. On retrouve donc, dans l'ordre :

**Injection** La pièce est d'abord moulée par un procédé d'injection standard. Le détail de cette étape sort du cadre de ce séminaire. On se référera à celui sur l'injection plastique [2].

**Activation** Le polymère ayant servi pour l'injection de la pièce a préalablement été dopé avec un composant organométallique qui est activé par le laser en suivant le tracé des pistes voulues. Une réaction physique décompose alors ce dopant entre partie métallique et partie organique. Les lasers utilisés sont typiquement des lasers infra-rouges d'une longueur d'onde  $\lambda = 1000 \text{ nm}$ .

**Métallisation** L'étape de métallisation commence par une étape de nettoyage, afin de faciliter l'accrochage. Les pistes sont ensuite construites par dépôt de fine couches (environ  $5 \mu\text{m}$ ). Finalement, un traitement de surface contre l'oxydation est appliqué. Ce traitement consiste généralement en une couche de nickel suivie d'une fine couche d'or, mais des traitements spécifiques, à base d'étain ou d'argent sont également possibles.

---

1. [www.lpkf.com](http://www.lpkf.com)

**Assemblage** Les composants électriques annexes (boutons, connecteurs, etc.) sont soudés sur le MID. Pendant le prototypage, cette étape est souvent faite à la main, avec un fer à souder. Pour la production, si le polymère a une température de fusion suffisamment élevée, l'assemblage par *reflow soldering* est possible. On peut se référer au séminaire [4] pour plus de détails.

### 3.1.2 Métallisation

Or	0.1 $\mu\text{m}$ - 12min
Nickel	6 $\mu\text{m}$ - 22min
Cuivre	6-8 $\mu\text{m}$ - 2h
POLYMERE	

Fig. 5: Différentes couches métalliques utilisées en MID. L'épaisseur ainsi que le temps nécessaire à la déposition sont également visibles.

L'étape de métallisation est celle qui va à proprement parler déposer les pistes sur le polymère. Afin de garantir le bon fonctionnement de cette étape, un rinçage de la pièce entre chaque bain est effectué, ainsi qu'un séchage à chaud après le dernier bain, afin d'enlever toute trace sur la pièce finale.

Le premier bain de cuivre se fait sans électrolyse, vu qu'aucune piste conductrice n'existe pour le moment. Dans ce bain, du cuivre va croître autour des atomes de métal présents à la surface du polymère et se liera aux microcavités résultant de l'activation laser. L'épaisseur maximum atteignable lors de ce premier bain est de 5 à 8  $\mu\text{m}$ .

Dans les applications à fort courant, une grande épaisseur de cuivre est souhaitée. Pour y parvenir, on peut, après le premier bain, faire une déposition électrolytique du cuivre. Pour cela, il faut que toutes les pistes soient connectées entre elles en un point. Si ce n'était pas le cas, il faudrait connecter les pistes une à une à l'électrode, ce qui serait long et donc coûteux. Le point de connexion est généralement placé sur une partie séparable mécaniquement qui est enlevée après la métallisation.

Une fois ce premier bain terminé, une couche de protection contre l'oxydation est appliquée. En effet une oxydation de la couche de cuivre ruinerait les propriétés électriques du circuit. Cette couche est généralement composée d'une couche de nickel suivie d'une couche d'or. Le rôle de cette dernière est d'empêcher

l'oxydation de la couche de cuivre, tandis que la couche de nickel sert à empêcher le cuivre de diffuser dans l'or, ce qui détruirait la protection anti-oxydation.

### 3.2 Two-shot molding

Le two-shot molding est un procédé antérieur au LDS et qui est dans le domaine public. Il est essentiellement utilisé dans le domaine de l'injection plastique, pour produire des pièces injectées de différentes couleurs, comme des touches de clavier d'ordinateur. Cette méthode consiste à d'abord mouler les pistes dans un polymère dopé, puis à "surmouler" la forme définitive de la pièce autour (fig. 6b). Finalement, la pièce est métallisée suivant le même procédé que dans le LDS, mais le cuivre ne se dépose que sur les parties exposées du polymère dopé (fig. 6c).

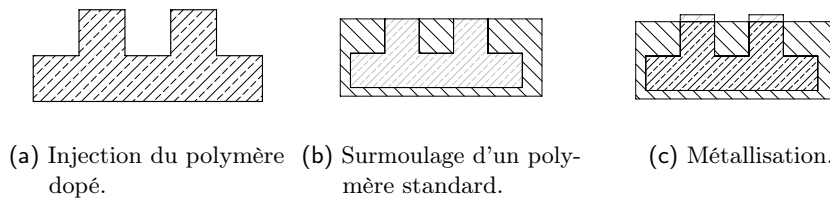


Fig. 6: Procédé two-shot

## 4 Conception de MID

La conception des MID commence par la création du schéma électrique dans un logiciel de conception électronique standard, puis le schéma est exporté sous forme de *netlist*, c'est à dire d'une liste de connexion entre différents composants. Le design mécanique du MID se fait dans un logiciel de DAO standard, comme Solidworks, puis est exporté au format STEP.

La *netlist* et le fichier STEP sont ensuite importés dans un logiciel spécifique<sup>2</sup> pour l'étape de routage (placement des pistes). Lors de cette étape, on place aussi des repères appelés *fiducials* qui seront utilisés par les machines d'activation et d'assemblage pour faire un alignement visuel. On peut également placer des codes-barres 2D (*datamatrix*) qui seront modifiés par la machine d'activation pour y placer un numéro de série, afin d'assurer le suivi des pièces.

### 4.1 Matériaux utilisables

Les contraintes inhérentes à la technologie LDS limitent fortement le choix des matériaux :

- la pièce étant injectée puis activée, le matériaux choisi doit être un thermoplastique,
- pour l'étape d'activation, le polymère doit pouvoir se lier avec un dopant organométallique, généralement à base de palladium,
- l'assemblage des composants par *reflow soldering* exige une température de fusion élevée.

2. Nextra de chez Mecadtron <http://www.mecadtron.com/produkte/nextra.en.php>



LPKF a donc créé une liste de matériaux utilisables et recommandés pour le LDS (voir tab. 1). Une liste de fournisseurs proposant ces matériaux déjà dopés est également disponible chez LPKF [8].

Type	Matériau
LCP	Liquid Crystal Polymer
PA 6/6T	Polyamide
PBT	Polytéréphtalate de butylène
PBT/PET	Mélange de PBT et de PET
PPA	Polyphthalamide
PC	Polycarbonate
PC/ABS	Mélange de PC et d'ABS

Tab. 1: Matériaux utilisables comme substrat

Source : [8]

## 4.2 Limites du procédé LDS

La conception de circuits MID est délicate car elle doit prendre en compte des limites provenant de l'injection plastique, de l'activation laser et de la métallisation. L'ingénieur doit donc porter un soin tout particulier à la conception, car de petits détails, comme des trous borgnes, peuvent augmenter significativement le coût de la pièce, voir même la rendre impossible à réaliser. L'ensemble des règles de conception à respecter est compilée dans un seul document, fourni par LPKF [8]. Nous allons ici nous concentrer sur les plus importantes.

La plus grosse limitation des MIDS par rapport aux PCBs est la faible densité de pistes atteignable. En effet, il est impossible de fabriquer des MIDS avec des couches internes, là où des circuits à 16 couches sont facilement atteignables dans le domaine des PCBs. De plus, les MIDS ne permettent pas de faire des pistes très fines ou très serrées : on considère généralement qu'il faut rester au-dessus de 150  $\mu\text{m}$  pour la largeur de piste et 200  $\mu\text{m}$  pour l'écart inter-piste.

De plus, l'angle d'incidence du laser (correspond à l'angle  $\beta$  sur la fig. 7) doit rester inférieur à 30° par rapport à la normale de la surface. Un angle plus important change la forme du spot du laser, qui passe d'un cercle à une ellipse, ce qui dissipe trop la puissance du laser et diminue la résolution. On peut néanmoins corriger ce problème en montant la pièce sur un support orientable, moyennant une perte de temps pour la rotation de la pièce et le réalignement optique de la machine. Un autre moyen de corriger ce problème est d'utiliser une machine avec plusieurs lasers orienté indépendamment. Dans les cas les plus extrêmes, on ne peut pas corriger ce problème de cette façon, et alors le passage au two-shot est inévitable. On préfère cependant souvent modifier la pièce pour rester sur une technologie LDS pour minimiser les coûts et faciliter le développement.

La dernière limitation concerne le volume de travail de la machine d'activation laser : environ 200 mm  $\times$  200 mm  $\times$  25 mm, légèrement variable d'une machine à l'autre.

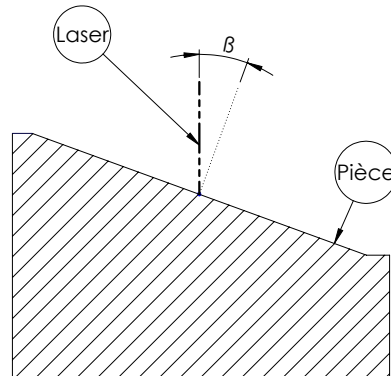


Fig. 7: Angle limite pour l'activation ( $\beta < 30^\circ$ ).

### 4.3 Prototypage

Le travail d'ingénieur étant un procédé itératif, il est important de pouvoir réaliser rapidement et à faible coût des prototypes fonctionnels d'une pièce ou d'un système. Le MID, et plus particulièrement l'étape d'injection plastique, n'est pas bien adapté au prototypage : lancer une série coûte cher et n'est pas un procédé rapide (jusqu'à six semaines).

Le LDS offre cependant différentes possibilités de prototypage simples, puisque la seule étape différente de la production est la création de la pièce de base en polymère. Les étapes d'activation et de métallisation sont donc inchangées par rapport à la production. Le prototypage sert autant à mettre au point le MID que le procédé de production, par exemple les supports pour la métallisation ou l'activation.

La première méthode (et la plus simple) pour prototyper une pièce en MID consiste à usiner sa forme dans un bloc de polymère déjà dopé. On utilise donc des machines d'usinage conventionnelles ou CNC, qui sont facilement disponibles, avant d'activer et de métalliser la pièce. Cette méthode a comme avantage de ne demander aucun équipement spécifique et d'être facilement réalisable par un opérateur sans formation sur une machine spéciale. Son principal inconvénient est que certaines pièces qui peuvent être injectées ne peuvent pas être usinées et inversement, ce qui rend cette technique inutile pour certaines pièces.

Une seconde méthode de prototypage consiste à réaliser en stéréolithographie ou en impression 3D la forme de la pièce puis à la peindre avec une laque spéciale vendue par LPKF, qui rend la surface activable après un bref passage au four, ce qui demande un polymère stable à  $90^\circ\text{C}$ . On utilisera donc de préférence de l'ABS. Cette méthode, comme la précédente, permet de réduire à environ une semaine le temps entre l'envoi d'une commande et la réception d'un prototype.

Toujours en utilisant la stéréolithographie ou l'impression 3D, il est possible de réaliser la forme de la pièce en positif, puis de couler un moule en silicone autour, pour l'utilisation dans une machine d'injection sous vide. On injecte ensuite la pièce en PUR dopé, qu'on peut activer et métalliser de façon standard. Cette

méthode a comme principal inconvénient de demander une machine spécifique pour l'injection sous vide, et ne de pas proposer de grands avantages par rapport aux deux méthodes précédentes. Elle n'est donc que rarement utilisée.

La dernière méthode de prototypage est réservée aux derniers tests avant la production en grande série, car c'est la plus onéreuse. Dans cette méthode, tout le procédé est rigoureusement identique au procédé final, la seule différence étant le type de moule : on utilise ici un *soft mold* en aluminium, plutôt qu'un moule en acier trempé. On arrive donc à un moule se comportant comme le vrai, ce qui est important pour tester tous les paramètres d'injection (température, vitesse d'injection, etc.), à un prix bien moindre : un *soft mold* coûte environ 10% du prix de son homologue en acier, mais ne permet de produire que 1000 pièces environ.

#### 4.4 Comparatif entre PCB et MID

Il est important de noter que les MIDs ne sont pas un remplaçant ou un successeur aux PCBs : ils répondent à des besoins différents. Par exemple, réaliser un circuit complexe mais sans intégration mécanique, comme une carte mère d'ordinateur, en MID n'est pas une bonne idée : la densité de pistes et d'éléments est beaucoup plus grande avec un PCB, tandis que les seules fonctions mécaniques demandées sont des perçages de fixations au boîtier. En revanche, dans le cas d'un ordinateur portable, la réalisation d'une antenne MID (WiFi, Bluetooth, etc.) est intéressante, étant donné son intégration facilitée au châssis. On voit dans cet exemple que la combinaison d'un MID et d'un PCB permet de tirer le meilleur des deux technologies.

En résumé, les principaux avantages des MIDs sont :

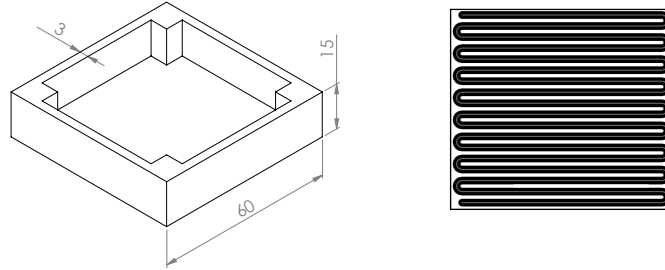
- les MIDs permettent une géométrie en trois dimensions tandis que les PCBs sont limités à un plan,
- ils permettent d'associer des fonctions mécaniques et électriques dans une seule pièce,
- la complexité (et donc le temps d'assemblage) est réduit par les MIDs, grâce à la diminution du câblage.

À l'inverse, leurs principaux inconvénients sont :

- les circuits en MID ne permettent pas une grande densité de pistes, car il n'est pas possible de faire des couches internes et que la résolution du procédé est limitée,
- l'assemblage des composants est plus difficile, car pas limité à un seul plan,
- faire des petites séries de MID est possible, mais très cher, tandis que les PCBs sont plus abordables car ils ne demandent pas de moules.

### 5 Étude de coûts

Pour notre étude de coûts, nous avons décidé de nous baser sur la série en production chez Cicorel lors de notre visite. Les tableaux de calculs de coûts restent néanmoins généralisables, moyennant un changement de certaines valeurs. Les paramètres à changer en fonction de la pièce sont indiqués dans le détail de chaque partie.



(a) Partie mécanique. Dimensions en mm. (b) Tracé des pistes (similaire pour les cinq faces intérieures).

Fig. 8: Pièce d'exemple. Les dimensions et la géométrie sont approximatives. La largeur des pistes et la distance entre deux pistes est de  $150\text{ }\mu\text{m}$ .

**Descriptif de la pièce** La pièce que nous considérons est une pièce relativement simple. Il s'agit d'un couvercle contre l'ingénierie inverse pour lecteur de carte de crédit. Le rôle de cette pièce est de détecter toute tentative d'accéder à l'intérieur de l'appareil, soit en le démontant, soit en le perçant. Pour accomplir cette fonction, deux pistes sont placées en serpentin à l'intérieur du couvercle. L'appareil est programmé pour effacer toutes les données sensibles dès qu'une de ces pistes est rompue. Cette pièce était malheureusement confidentielle et nous n'avons pas pu la prendre en photo. On peut l'approximer par la boîte creuse visible à la fig. 8.

## 5.1 Injection

L'étape d'injection plastique demande un moule usiné soit par électroérosion, soit par usinage à grande vitesse. Le coût du moule a été estimé suivant les calculs présentés dans le séminaire[3]. Le détail de ces calculs sortant du cadre du présent séminaire, nous avons fait le choix de ne pas les inclure.

Nous avons également supposé que la pièce est réalisée dans la matière la moins chère, c'est à dire le polycarbonate (PC). Les polymères activables sont en moyenne 20% plus cher que leur homologue non activable d'après notre contact chez Cicorel. Les prix des matériaux varient entre 11 CHF/kg pour du PC et 220 CHF/kg pour du PEEK.

<b>Électricité</b>		
Consommation électrique	5	kW
Prix de l'électricité	0.2	CHF/(kW h)
Coût d'électricité	1	CHF/h
<b>Machines</b>		
Machine d'injection	130 000	CHF
Fonctionnement	6240	h/année
Amortissement sur 5 ans	4.17	CHF/h
<b>Opérateurs</b>		
Opérateur à 10%	6	CHF/h
<b>Matière</b>		
Matière (PC)	11	CHF/kg
Poids de la pièce	25	g
Coût de la matière	0.27	CHF/pièce
<b>Outillage</b>		
Prix du moule	20 000	CHF
Pièces par série	500 000	pièce
Coûts d'outillage	0.04	CHF/pièce
Coût horaire	11.17	CHF/h
Temps de cycle	20	s/pièce
<b>TOTAL</b>	0.38	CHF/pièce

Tab. 2: Calcul des coûts de l'injection plastique

## 5.2 Activation Laser

Pour calculer le coût de l'étape d'activation sélective (LDS) nous avons fait quelques hypothèses :

- Le secteur d'activation laser tourne 24 h par jour, 5 jours sur 7.
- La machine est une Microline 160i de chez LPKF coûtant 220 000 CHF. Elle est amortie en 5 ans.
- Un opérateur ne peut s'occuper que d'une machine à la fois.
- La machine consomme en permanence sa puissance de pointe soit 2.5 kW [7]. L'électricité représentant une fraction faible du coût final, cette hypothèse n'induit pas de grandes erreurs.

Le calcul de la surface occupée par les pistes sur notre circuit se base sur une largeur de piste de 150  $\mu\text{m}$  et une distance entre deux pistes de 150  $\mu\text{m}$  également, pour une piste occupant toute la surface du circuit. Pour une autre pièce, la surface des pistes peut souvent être obtenue dans le logiciel de conception.

<b>Électricité</b>		
Consommation électrique	2.5	kW
Prix de l'électricité	0.2	CHF/(kW h)
Prix de l'électricité	0.5	CHF/h
<b>Machines</b>		
LPKF Microline 160i	220 000	CHF
Fonctionnement	6240	h/année
Amortissement sur 5 ans	7.05	CHF/h
<b>Opérateurs</b>		
Opérateur à 100%	60	CHF/h
<b>Temps de cycle</b>		
Vitesse du laser	4000	mm/s
Diamètre du laser	80	$\mu\text{m}$
Vitesse de balayage	320	$\text{mm}^2/\text{s}$
Surface des pistes	3000	$\text{mm}^2/\text{pièce}$
Temps de balayage	9.375	s/pièce
Temps de positionnement	1	s/orientation
Nombre d'orientations	5	
Temps de mise en place, retrait et inspection	15	s/pièce
<b>Temps total</b>	<b>29.375</b>	<b>s/pièce</b>
Coût horaire	67.68	CHF/h
Temps de cycle	29.375	s/pièce
<b>TOTAL</b>	<b>0.55</b>	<b>CHF/pièce</b>

Tab. 3: Calcul des coûts de l'activation sélective par laser

## 5.3 Métallisation

Calculer le coût réel de cette étape est difficile, car beaucoup d'informations ne sont pas accessibles publiquement : le prix des bains et de la station d'épuration

des eaux usées (STEP) pour ne citer que ces deux là, ne sont pas disponibles chez les fournisseurs. De plus, filtrer les bains pour les recycler permet de récupérer un peu de matière qui est revendue, ce qui intervient dans le calcul de coût, mais est difficile à estimer. Finalement, notre contact chez Cicorel a refusé de détailler leur méthode de calculs pour ces bains, en nous répondant qu'il s'agissait de données internes et confidentielles.

Nous avons donc estimé que le coût pour déposer 1 kg de métal par voie chimique était environ cinq fois le prix de ce métal sur le marché. Ce coût inclut la STEP, le chauffage des bains et l'électricité consommée par le robot servant à déplacer les pièces d'un bain au suivant. Cette estimation peut sembler hasardeuse, mais elle donne néanmoins une approximation suffisante pour l'ingénieur désireux d'utiliser ce procédé. À ce coût, il faut ajouter l'amortissement de la machine sur cinq ans et l'opérateur (deux opérateur pour trois lignes).

Pour estimer le temps de cycle, nous avons retenu le temps de l'étape la plus longue, c'est à dire la déposition du cuivre. En effet, une fois un rack sorti du bain de cuivre, un autre peut prendre sa place tandis que le premier continue dans la chaîne.

<b>Machines</b>		
Chaîne de bains	1 000 000	CHF
Fonctionnement	6240	h/année
Amortissement sur 5 ans	32	CHF/h
<b>Opérateurs</b>		
Opérateur à 66%	40	CHF/h
<b>Matière</b>		
Cuivre chimique	100	CHF/kg
Nickel chimique	100	CHF/kg
Or chimique	175 000	CHF/kg
Couche de cuivre (6 $\mu\text{m}$ )	5.34	CHF/ $\text{m}^2$
Couche de nickel (6 $\mu\text{m}$ )	5.34	CHF/ $\text{m}^2$
Couche d'or (0.05 $\mu\text{m}$ )	168.875	CHF/ $\text{m}^2$
Surface de piste	$3 \times 10^{-3}$	$\text{m}^2/\text{pièce}$
Coût de la matière	0.54	CHF/pièce
Coût horaire	72	CHF/h
Temps de cycle	2	h
Pièces par bain	400	
<b>TOTAL</b>	0.90	CHF/pièce

Tab. 4: Calcul des coûts de la métallisation.

## 5.4 Récapitulatif

Le calcul des coût appliqué au couvercle d'exemple (fig. 8) donne le résultat visible dans le tab. 5. Les fig. 9 et 10 montrent la répartition des coûts en fonction de l'étape de fabrication et de leur source.

Injection	0.38	CHF/pièce
Activation sélective	0.55	CHF/pièce
Métallisation	0.90	CHF/pièce
<b>TOTAL</b>	<b>1.83</b>	<b>CHF/pièce</b>

Tab. 5: Récapitulatif des coûts.

## 5.5 Comparaison avec un PCB

Pour bien illustrer les avantages des MIDs dans ce type d'applications, nous avons imaginé une autre solution pour cette fonction, qui utilise un PCB fixé dans une coque en PC moulée par injection. Les principales différences à prendre en compte sont :

- Le prix de la matière de la coque, 3 CHF/kg pour du PC standard, contre 11 CHF/kg pour sa variante activable.
- Le coût de fabrication du PCB équivalent. Dans cet exemple, nous considérons un PCB qui ne couvre que le fond du boîtier, contrairement à une solution MID qui couvre également les parois latérales.
- On considère que le PCB est fixé mécaniquement au boîtier et que cette étape est faite à la main.
- Un connecteur doit être soudé sur le PCB tandis qu'en MID le connecteur est intégré directement dans la pièce.

Pour calculer le coût du PCB nous avons utilisé le séminaire[9], avec les paramètres suivants :

- Dimensions de la carte : 60x60 mm.
- Circuit monocouche.
- Pas de via, pas de trous.
- Pas de sérigraphie.

Nous arrivons donc à un coût de 3.13 CHF/pièce. A ce coût s'ajoutent le connecteur et son assemblage (0.5 CHF/pièce), le boîtier injecté (0.2 CHF/pièce) et l'assemblage du PCB dans ce dernier par l'opérateur (10 s à 1 CHF/min soit 0.15 CHF/pièce). On arrive à un total d'environ 4 CHF/pièce soit deux fois plus que l'alternative MID, tout en offrant une moins bonne protection contre l'intrusion sur les côtés.

Étant donné l'économie réalisée sur une pièce aussi simple, on imagine facilement celle sur une pièce beaucoup plus compliquée géométriquement et mécaniquement, comme le volant de la figure 1. On comprend donc l'intérêt financier et technique des MIDs ainsi que la croissance rapide de ce marché.



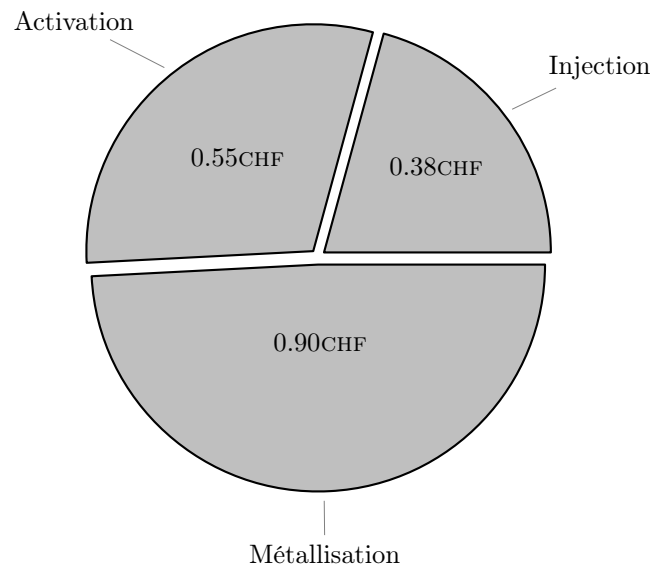


Fig. 9: Répartition des coûts selon les étapes pour la pièce d'exemple.

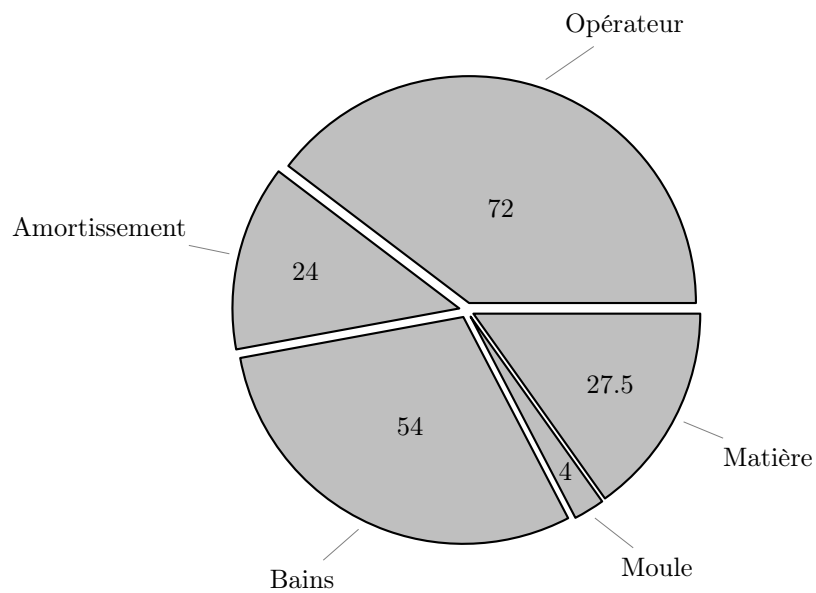


Fig. 10: Source des différents coûts (en centimes). L'électricité n'est pas affichée, car négligeable.

## 6 Remerciements

Nous voudrions remercier l'entreprise Cicorel S.A., particulièrement M. D. Duhm et M. W. Honstein, du secteur 3D-MID, pour le temps qu'ils nous ont consacré pour la visite de leur entreprise et les réponses à nos questions. Nous remercions également le Pr. J. Jacot pour son aide lors du calcul des coûts.

## Références

- [1] S. AMATI, M. GUNN et G. VETSCH : Molded Interconnect Devices. Rap. tech., EPFL, Décembre 2012.
- [2] C. BOISSONAS, J. BREGNARD et M. GRANDJEAN : Injection Plastique. Rap. tech., EPFL, Novembre 2013.
- [3] B. CALDAS et B. DA SILVA : Électroérosion. Rap. tech., EPFL, Octobre 2013.
- [4] S. T. GOY et B. C. D. VERMOT : Montage des composants SMD. Rap. tech., EPFL, Octobre 2013.
- [5] N. HEININGER, W. JOHN et H.-J. BOSSLER : Manufacturing of molded interconnect devices from prototyping to mass production with laser direct structuring. *In International Congress MID*, 2004.
- [6] L. LEIMBRUGER et K. KANGUR : Molded Interconnect Devices. Rap. tech., EPFL, Décembre 2011.
- [7] LPKF LASER & ELECTRONICS AG : Laser Direct Structuring of 3D Circuit Carriers : LPKF MicroLine 3D. Product Brochure.
- [8] LPKF LASER & ELECTRONICS AG : Design rules for laser direct structured MID components. Application Note, Septembre 2010.
- [9] Y. MOTTAS et S. KOMI : Fabrication de circuits imprimés. Rap. tech., EPFL, Octobre 2013.
- [10] SUMITOMO (SHI) DEMAG PLASTICS MACHINERY GMBH : Multi-component technology. <http://www.sumitomo-shi-demag.eu/processes/multi-component-technology/rotary-plate.html>, Octobre 2012.